

(54) [Title of the Invention] THIN FILM OF CHROMIUM-BASE ALLOY,
MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND STRAIN GAUGE

(57) [Abstract]

[Object] The object of the invention is to provide a thin film of a Cr-base alloy comprising Cr and desired sub-components, and having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$, and a method for manufacturing the same. Another object of the invention is to provide a strain gauge comprising the thin film of the alloy.

[Construction] A thin film of a Cr-base alloy for a strain gauge having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$, and comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5 % or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8 % or less each of Zn, Cu and Bi, 10 % or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15 % or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20 % or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[Scope of Claims]

[Claim 1] A thin film of a Cr-base alloy for a strain gauge having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$, and comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[Claim 2] A method for manufacturing a thin film of a Cr-base alloy for a strain gauge having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$, which comprises depositing the thin film on an insulation film formed on a conductive substrate or on an insulating substrate, by vapor deposition or sputtering, wherein said thin film comprises, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[Claim 3] A method for manufacturing a thin film of a Cr-base alloy for a strain gauge having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$, which comprises depositing the thin film on an insulation film formed on a conductive substrate or on an insulating substrate, by vapor deposition or sputtering, and cooling after heating at a temperature of 100°C or more and 1200°C or less in a non-oxidizing gas, reducing gas or vacuum, wherein said thin film comprises, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P,

Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[Claim 4] A strain gauge comprising a thin film of a Cr-base alloy having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within (-3.5 to 3.5) × 10⁻⁴/°C on an insulation film formed on a conductive substrate or on an insulating substrate, said thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50% of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[Claim 5] A strain gauge having a metal electrode formed on or under a thin film of a Cr-base alloy having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within (-3.5 to 3.5) × 10⁻⁴/°C on an insulation film formed on a conductive substrate, or on an insulating substrate, said thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50% of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[Claim 6] A strain gauge comprising a thin film of a Cr-base alloy having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within (-3.5 to 3.5) × 10⁻⁴/°C by depositing the thin film on an insulation film formed on a conductive substrate, or on an insulating substrate, by vapor deposition or sputtering followed by cooling after

heating at a temperature of 100°C or more and 1200°C or less in a non-oxidizing gas, reducing gas or vacuum, said thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[Claim 7] A strain gauge having a metal electrode formed on or under a thin film of a Cr-base alloy having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ on an insulation film formed on a conductive substrate, or on an insulating substrate, by vapor deposition or sputtering followed by cooling after heating at a temperature of 100°C or more and 1200°C or less in a non-oxidizing gas, reducing gas or vacuum, said thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Field of the Invention] The invention relates to a thin film of a Cr-base alloy comprising Cr (chromium) as a principal component, and 0.001 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of Ti (titanium), V (vanadium), Nb (niobium), Ta (tantalum), Ni (nickel), Zr (zirconium), Hf (hafnium), Si (silicon), Ge (germanium), C (carbon), N (nitrogen), P (phosphorous), Se (selenium), Te (tellurium), Fe (iron), Mo

(molybdenum), W (tungsten), As (arsenic), Sn (tin), Sb (antimony), Pb (lead), Bi (bismuth), Al (aluminum), B (boron), Ga (gallium), In (indium), Tl (thallium), Cu (copper), Zn (zinc), Mn (manganese), Ru (ruthenium), Rh (rhodium), Re (rhenium), Os (osmium), Ir (iridium), Pt (platinum), Pd (palladium), Ag (silver), Au (gold), rare earth elements, Co (cobalt), Be (beryllium), Mg (magnesium), Ca (calcium), Sr (strontium) and Ba (barium); a manufacturing method thereof; and a strain gauge using the thin film of the alloy. The object of the invention is to provide the thin film of the alloy having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^4/\text{°C}$. Another object of the invention is to provide a strain gauge comprising the thin film of the alloy.

[0002]

[Related Art] While the strain gauge takes advantage of a phenomenon in which electric resistance of a gauge material such as a fine wire or foil changes by elastic strain, it may be conversely used for measuring and converting a stress and strain by measuring a change of electric resistance. For example, this phenomenon is widely used for strain gauges, weighting level gauges, accelerometers and various mechanical quantity-electric variable converters in manufacturing industries, earth pressure gauges in civil engineering, pressure gauges and deflection gauges in building and energy-related industries, and various stress-strain gauges in aircraft, space, railway and shipping industries, as well as in civil life uses such as over-the-counter valances and security instruments.

[0003] In the structure of the strain gauge, a metal fine wire (with a diameter of 10 to 30 μm) or a metal foil (with a thickness of 3 to 5 μm) is disposed as a grid or rosette. The strain gauge is used by adhering it on a measuring object with an adhesive, and the strain generated in the measuring object is indirectly measured from the changes of the electric resistance of the gauge. The sensitivity of the strain gauge is usually given by the K-value defined in the following equation:

[0004]

[Formula 1]

$$K = \frac{\Delta R / R}{\Delta \ell / \ell} = 1 + 2\sigma + \frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta \ell / \ell}$$

[0005] **R, σ, ρ and l** denote the total electric resistance, Poisson's ratio, specific electric resistivity and total length, respectively, of the gauge fine wire or foil. Since σ in metals and alloys is usually about 0.3, the total value of the first term and second term in the right side of the above equation is a constant value of about 1.6. Accordingly, it is an essential condition that the third term is large for increasing the gauge factor. In other words, this condition depends on a large change of electroic structures of the material in the direction of length when a tensile deformation is given to the material to thereby increase the amount of change ρ/ρ of specific electric resistivity.

[0006] Semiconductors such as carbon and germanium are known to have a large gauge factor. However, although the gauge factor is quite as large as 10 to 170 in these semiconductors, anisotropy and temperature variation of the value are also large to render the gauge factor unstable, while the mechanical strength of the material is poor. Therefore, these materials are only applied for specialized small scale pressure transducers. The most frequently used materials as the strain gauge materials today are Cu-Ni alloys. While these alloys are featured in small variation of characteristics against temperature changes due to their quite small temperature coefficient of electric resistance, they have a small gauge factor of 2 that makes them unsuitable as strain gauge materials.

[0007] The strain gauge using alloy materials is used as a fine wire or foil as described above. However, characteristics of the strain gauge of a fine wire type are largely varied due to the effect of residual strain for forming a grid and the effect of adhesives used for adhering a processed fine wire to a substrate. In addition, since a special technique is required for forming the grid and for adhering the grid onto the substrate, production efficiency is poor to make the production cost expensive. While the strain gauge of the foil type does not suffer from strain by processing, the effect of the adhesive is the same as in the fine wire material. These problems are required to be solved.

[0008]

[Problems to be Solved by the Invention] The application field of the strain gauge is increasing still more in accordance with the progress of microcomputers, and the strain gauge is being attempted to be more small size and to exhibit high performance. In particular, strain gauges capable of being used for pressure transducers and load cells that require high sensitivity and stability, as well as touch sensors and slip sensors of robot have been increasingly required. It is an urgent requirement to develop materials having high sensitivity and good stability for the strain gauge for these sensors, and to improve the manufacturing process thereof.

[0009] The problem to be solved by the invention is to develop a thin film material having a gauge factor of exceeding 2 that is the gauge factor of commercially available strain gauges, and a small temperature coefficient of electric resistance that is desirable to be within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$, and to develop the manufacturing process of the material. The object of the invention is concentrated on structurally stable metallic materials as the materials having high sensitivity and good stability, and the inventors have noticed Cr among these materials that have high gauge factors.

[0010] A bulk (mass) of Cr has been known to have a strain sensitivity of electric resistance of quite as large as 26 to 28. However, since processing of Cr is quite difficult, it was hitherto impossible to use for fine wires or foils of the strain gauge. Accordingly, it may be devised to apply Cr to the strain gauge by forming into a thin film without any processing. The thin film of Cr has a gauge factor of as large as 14.8, although the value is not as large as the gauge factor of the bulk material. However, while it is essential that the rate of change of electric resistance at room temperature is small, the Cr thin film has a large negative temperature coefficient of electric resistance of $-6 \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$, and is not suitable for use in the strain gauge with respect to stability.

[0011] Accordingly, the object of the invention is to obtain a thin film for the strain gauge having a high sensitivity and being highly stable by reducing the temperature

coefficient of electric resistance while maintaining a high gauge factor of the Cr thin film as much as possible.

[0012]

[Means for Solving the Problems] It was noticed in the invention that the change of electric resistance is small in a minimum or maximum area of temperature variations of specific electric resistivity as shown in Fig. 1, and a method for shifting this region to room temperature was investigated. It has been known that the temperature at the Neel point (Neel temperature) of the bulk Cr shifts to a lower temperature side or higher temperature side by adding certain elements. Therefore, various elements as sub-components were added to Cr based on the idea that the maximum and minimum temperature changes of electric resistance are closely related to the Neel point, and the relationship between the amount of addition of the sub-components and the maximum and minimum regions was intensively studied. As a result, it was made clear that the maximum or minimum region can be shifted to near room temperature by adding an appropriate amount of sub-components to Cr to thereby enable the temperature coefficient of electric resistance to be reduced at near room temperature.

[0013] It was also made clear that, when the strain gauge is used at a temperature other than room temperature, a strain gauge having a small temperature coefficient of electric resistance in a desired temperature range could be provided by appropriately selecting the kind and amount of the elements added to Cr.

[0014] Based on these discoveries and various experiments, it was found that a thin film of a Cr-base alloy for a strain gauge comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; and 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5 % or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8 % or less each of Zn, Cu and Bi, 10 % or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15 % or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20 % or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities,

and having a large gauge factor and a small temperature coefficient of electric resistance at near room temperature could be obtained, and that the thin film is suitable for the material of the high sensitivity strain gauge.

[0015] For manufacturing of the thin film of the Cr-base alloy of the invention, a thin film with a desired shape and thickness is formed on an insulation film formed on a conductive substrate or on a insulating substrate using a mask formed by vapor deposition of the alloy comprising the compositions described above, by sputtering using an alloy target, a composite target or multi-component target capable of forming a thin film having the composition as described above, or by a vapor phase transport method capable of forming a thin film having the composition described above, followed by applying an etching process or a trimming process such as dry etching (plasma etching, sputter etching and the like), chemical etching (corroding method) or laser trimming method to form an element. A gauge pattern is formed, if necessary, for temperature compensation by disposing an element aligned perpendicular to the element above. The thin film may be directly used or, if necessary, an electrode is formed on the element. The thin film is heated, if necessary, at a temperature of 100°C or more and 200°C or less in the air, in a non-oxidative gas or in a reducing gas for an appropriate time, preferably for 1 second or more and 100 hours or less, followed by cooling at an appropriate rate, preferably 1 °C/hour or more and 100 °C/min or less. Then, a thin film of the Cr-base alloy with a strain sensitivity of electric resistance (gauge factor) of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/\text{°C}$ is obtained.

[0016] First Invention

A thin film of a Cr-base alloy for a strain gauge having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/\text{°C}$, the thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5 % or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8 % or less each of Zn, Cu and Bi, 10 % or less each of Fe,

Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[0017] Second Invention

A method for manufacturing a thin film of a Cr-base alloy for a strain gauge having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ by depositing the thin film on an insulation film formed on a conductive substrate, or on an insulating substrate, by vapor deposition or sputtering, the thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50% of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[0018] Third Invention

A method for manufacturing a thin film of a Cr-base alloy for a strain gauge having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ by depositing the thin film on an insulation film formed on a conductive substrate, or on an insulating substrate, by vapor deposition or sputtering followed by cooling after heating at a temperature of 100°C or more and 1200°C or less in a non-oxidizing gas, reducing gas or vacuum, the thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50% of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[0019] Fourth Invention

A strain gauge comprising a thin film of a Cr-base alloy having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ on an insulation film formed on a conductive substrate, or on an insulating substrate, the thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5 % or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8 % or less each of Zn, Cu and Bi, 10 % or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15 % or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20 % or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[0020] Fifth Invention

A strain gauge having a metal electrode formed on or under a thin film of a Cr-base alloy having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ on an insulation film formed on a conductive substrate, or on an insulating substrate, the thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5 % or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8 % or less each of Zn, Cu and Bi, 10 % or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15 % or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20 % or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[0021] Sixth Invention

A strain gauge comprising a thin film of a Cr-base alloy having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ by depositing the thin film on an insulation film formed on a conductive substrate, or on an insulating substrate, by vapor deposition or sputtering followed by cooling after heating at a temperature of 100°C or more and 1200°C or less in a non-oxidizing gas, reducing gas or

vacuum, the thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[0022] **Seventh Invention**

A strain gauge having a metal electrode formed on or under a thin film of a Cr-base alloy having a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ on an insulation film formed on a conductive substrate, or on an insulating substrate, by vapor deposition or sputtering followed by cooling after heating at a temperature of 100°C or more and 1200°C or less in a non-oxidizing gas, reducing gas or vacuum, the thin film comprising, in atomic %, Cr (a balance) as a principal component; 0.01 to 50 % of a combined amount of one or two or more elements of 5% or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8% or less each of Zn, Cu and Bi, 10% or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15% or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20% or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities.

[0023]

[Operation] As shown in Fig. 1, the temperatures of the maximum and minimum regions are about 90°C and -150°C. Two methods of employing the minimum region by adding elements that serve the Neel temperature to shift to a lower temperature side and employing the maximum region by adding elements that serve the Neel temperature to shift to a higher temperature side may be conjectured for allowing these temperature regions to shift to room temperature in order to reduce the temperature coefficient of electric resistance at room temperature.

[0024] Figs. 2 to 7 show the relationship between the amount of addition of each element, and the temperature coefficient of electric resistance in the region of 0 to 50°C and the gauge factor at room temperature (about 20°C). As shown in these graphs, the reason why the composition of the thin film of the Cr-base alloy is restricted within respective ranges of 0.01 to 50 %, preferably 0.1 to 40 % and more preferably 1 to 40 % of a combined amount of one or two or more elements of 5 % or less each of Ti, V, Nb, Ta, Ni, Zr, Hf, Si, Ge, C, N, P, Se and Te, 8 % or less each of Zn, Cu and Bi, 10 % or less each of Fe, Mo, W, As, Sn, Sb, Pb, B, Ga, In and Tl, 15 % or less each of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt, Pd, Ag, Au and rare earth elements, and 20 % or less each of Co, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Mn and Al as sub-components; and a small amount of impurities, and a balance of Cr is that a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of within (-3.5 to $3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ are obtained in these ranges, while such effect cannot be expected in out of these ranges.

[0025] Although the thin film containing Hf, Zr, P, As, Sb, Mg, Ca, Co and Pd of the sub-components shows a temperature coefficient of electric resistance of within (-3.5 to $3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ even when the ranges thereof exceed limiting ranges, the surface of the thin film containing more than 5 % of Hf and Zr becomes extremely rough without stabilizing the characteristics at all, the thin film containing more than 5 %, 10 % and 20 % of P and As, Sb and Mg, and Ca, respectively, is peeled from the substrate, and the thin film containing more than 15 % and 20 % of Pd and Co, respectively, has a gauge factor of smaller than 2. Accordingly, the upper limits for these elements were provided since the films containing the above-mentioned elements in the ranges described above cannot be used as the strain gauge.

[0026] While Figs. 2 to 7 show that the gauge factor decreases in accordance with the increase of the amount of addition of the sub-components, the decrease of the gauge factor is small relative to the increase of the amount of addition of the sub-components such as C, Si, Ge, Al and Ga, and even a small amount of addition of sub-components such as Ni, Nb

and Ti permits the minimum point to shift to room temperature. Accordingly, a high gauge factor may be obtained by adding these elements. A high gauge factor can be obtained by adding a plurality of these elements that permit the high gauge factor to be obtained, and a large gauge factor of more than 2 could be obtained by adding at least two sub-components of sub-components according to the invention.

[0027] While the rare earth elements comprises Sc, Y and lanthanide elements (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu), all of them are the components having the same effect.

[0028] Fig. 8 shows the relationship between the heating temperature and the temperature coefficient of electric resistance, specific electric resistivity and gauge factor of the alloy (sample No. 13) according to the invention. As shown in the graph, desired gauge characteristics may be obtained by heating the alloy of the invention in the temperature range of 100°C or more to 1200°C or less for more than 1 minute or more to 100 hours or less, followed by cooling at a rate of 1 °C/hr or more to 1000 °C/min or less. The heating time is restricted to preferably 1 minute or more to 100 hours or less in the temperature range of 100°C or more to 1200°C or less in the heat treatment condition, because this condition is preferable for obtaining a gauge factor of 2 or more and a temperature coefficient of electric resistance of $(-3.5 \text{ to } 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$. Temperature ranges of 100°C or less and 1200°C or more are not preferable since no changes are observed in the gauge characteristics in the former case while the manufacturing process is wasteful with unfavorable economical efficiency in the latter case.

[0029]

[Examples] Examples of the invention will be described hereinafter.

Example 1: Manufacturing and evaluation of thin film of alloy of sample No. 7
(composition: Cr-5.8 % Fe)

A composite target for sputtering is prepared by bonding a Cr disk (purity 99.9 %) with a diameter of 105 mm and a thickness of 3 mm, followed by bonding 4 sheets

of Fe chip plates (purity 99.9 %) with an area of $7 \times 7 \text{ mm}^2$ and a thickness of 0.8 mm. A thin film with a thickness of 0.36 μm is prepared from this composite target using a magnetron high frequency sputtering apparatus under the sputtering condition shown below. A glass mask was covered on the substrate before deposition in order to form a patterned thin film by deposition.

Pre-evacuation: 1×10^{-7} Torr

High frequency wave power: 100 w

Argon gas pressure: 1×10^{-2} Torr

Substrate: glass (Corning #0211)

Temperature of substrate: not heated

Inter-electrode space: 50 mm

Deposition rate: 30 $\text{\AA}/\text{min}$

An electrode was formed by welding a covered lead wire with a diameter of 0.05 mm to the thin film prepared using a solder, and the temperature coefficient of electric resistance was measured by a four probe method. As shown in Table 1, a temperature coefficient of electric resistance of quite as small as $0.18 \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ and a gauge factor of 5.6 were obtained. Subsequently, the thin film obtained was heated at each temperature between 100 to 500 $^\circ\text{C}$ for an appropriate time in respective atmospheres, followed by cooling to room temperature (cooling rate: 200 $^\circ\text{C}/\text{hr}$). Table 1 shows the relationship between the heat treatment method, and temperature coefficient of electric resistance, specific electric resistivity and gauge factor after the heat treatment. The gauge factor was improved with a large value in any of the atmospheres. While the temperature coefficient of electric resistance showed a little increase in accordance with the increase of the heat treatment temperature, the change was not in the range that interferes with stability as the strain gauge.

[0030]

[Table 1]

Heat Treatment			Gauge Factor K (20°C)	Specific Electric Resistivity (20°C) (μΩ·cm)	Temp. Coefficient of Electric Resistance (0 to 50°C) (× 10 ⁻⁴ /°C)
Atmosphere	Temp. (°C)	Time (h)			
As-depo	-	-	5.6	94.74	0.18
In Air	400	10	8.1	90.47	0.42
In H ₂ stream	450	5	7.9	88.72	0.52
In vacuum	500	30	8.3	91.56	0.40
In vacuum	200	80	7.2	92.94	0.29

[0031] Example 2: Manufacturing and evaluation of thin film of alloy of sample No. 13
(composition: Cr-1.0 % V)

Cr with a purity of 99.9 % and V were formed into an alloy by arc melting to prepare an alloy target with a diameter of 203 mm and a thickness of 5 mm. The alloy target was bonded to a copper electrode as a sputtering target. A thin film with a thickness of 0.36 μm was prepared from this target using an ion-beam sputtering apparatus under the sputtering condition described below. The substrate was covered with a glass mask so as to form a gauge pattern by deposition, and a laminated electrode of Ni and Au was formed on the substrate.

Pre-evacuation: 2×10^{-8} Torr

Acceleration voltage: 700 V

Ionic current density: 2 mA/cm²

Substrate: Stainless steel having a SiO₂ insulation film on the surface

Temperature of substrate: 500°C

Ion source-target distance: 120 mm

Substrate-target distance: 120 mm

Deposition rate: 90 Å/min

An Au wire was welded to the thin film electrode prepared, and the temperature

coefficient of electric resistance and gauge factor were measured by a four-probe method to obtain a temperature coefficient of electric resistance of quite as small as $0.08 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ and a gauge factor of quite as large as 9.1. Subsequently, the thin film obtained was heated at each temperature in the range of 100°C to 1200°C for an appropriate time followed by cooling to room temperature in a furnace (cooling rate: $50\ ^{\circ}\text{C}/\text{hr}$). Table 2 shows the relationship between the heat treatment method, and temperature coefficient of electric resistance, specific electric resistivity and gauge factor after the heat treatment. The gauge factor was improved in any of the atmospheres, and showed a large value. Fig. 8 shows the relationship between the heating temperature, and the temperature coefficient of electric resistance, specific electric resistivity and gauge factor when the heat treatment was applied for 2 hours in vacuum. Both the gauge factor and the temperature coefficient of electric resistance showed a maximum at 500°C , although the specific electric resistivity was decreased with the increase of the heating temperature. Since the increment of the temperature coefficient of electric resistance caused by this heat treatment is as small as about $0.3 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$, and the increase of the gauge factor is more evident, the heat treatment of the invention is effective for manufacturing a strain gauge being highly sensitive and stable.

[0032]

[Table 2]

Heat Treatment			Gauge Factor K (20°C)	Specific Electric Resistivity (20°C) (μΩ·cm)	Temp. Coefficient of Electric Resistance (0 to 50°C) (× 10 ⁻⁴ /°C)
Atmosphere	Temp. (°C)	Time (h)			
As-depo	-	-	9.4	62.04	0.08
In Air	450	10	10.1	58.7	0.32
In H ₂ stream	500	5	10.1	59.3	0.25
In vacuum	400	30	10.4	54.3	0.32
In vacuum	800	80	9.6	60.2	0.09

[0033] Example 3: Manufacturing and evaluation of thin film of alloy of sample No. 53

(composition: Cr-1.2% Al-1.6% Si)

Cr with a purity of 99.99%, Al with a purity of 99.9% and Si with a purity of 99.99% in a proportion of 97.0%, 1.3% and 1.7%, respectively, were formed into an alloy by melting in a high frequency melting furnace to prepare an alloy, and about 1 g of the alloy was used as a evaporation source material. A thin film with a thickness of 1.2 μm was prepared using this material by vacuum deposition in a vacuum deposition apparatus under the condition below. The substrate was covered with a glass mask before deposition so as to form a gauge pattern by deposition.

Degree of vacuum: 6×10^{-7} Torr

Substrate: polyimide (a thickness of 0.1 mm)

Temperature of substrate: 200°C

Substrate-evaporation source distance: 180 mm

Deposition rate: 130 Å/min

The thin film prepared was taken out of the vacuum deposition apparatus and, after exchanging the mask covering the substrate, a Cu film for the electrode was formed in the vacuum deposition apparatus. A coated wire with a diameter of 0.2 mm was welded using a solder, and the temperature coefficient of electric resistance and gauge factor were

measured by a four-probe method. As a result, a temperature coefficient of electric resistance of as small as $-0.24 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ and a gauge factor of as large as 7.9 were obtained. Subsequently, after heating the thin film obtained at each temperature in the range of 100°C to 400°C for an appropriate time, it was cooled to room temperature in the furnace (cooling rate: 500 °C/hr). Table 3 shows the relationship between the heat treatment method, and the temperature coefficient of electric resistance, specific electric resistivity and gauge factor after the heat treatment. The gauge factor was improved in any of the atmospheres as in Example 1, and showed a large value. While the temperature coefficient of electric resistance was a little increased in accordance with the increase of the heat treatment temperature, the increase was not so large for interfering with the stability as a strain gauge. It was shown that a strain gauge being highly sensitive and stable could be provided by using the alloy of the invention.

[0034]

[Table 3]

Heat Treatment			Gauge Factor K (20°C)	Specific Electric Resistivity (20°C) ($\mu\text{Q}\cdot\text{cm}$)	Temp. Coefficient of Electric Resistance (0 to 50°C) ($\times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$)
Atmosphere	Temp. (°C)	Time (h)			
As-depo	-	-	7.9	99.36	-0.24
In Air	330	10	9.1	96.21	0.22
In H ₂ stream	400	5	9.4	94.33	0.31
In vacuum	380	30	8.3	98.87	0.30
In vacuum	280	80	8.1	97.92	0.15

[0035] Tables 4 and 5 show the temperature coefficient of electric resistance (TCR), specific electric resistivity (σ) and gauge factor (K) of the representative thin film of the alloy according to the invention with respect to the samples after depositing the thin film on the surface of the stainless steel substrate on which a SiO₂ insulation film is formed using a high frequency sputtering apparatus, and the samples after subjecting the thin film to heat treatments under various conditions.

[0036]

[Table 4]

Sample No.	Composition of Sub-Component (Cr as a balance)	Heat Treatment			Gauge Factor (20°C)	Specific Electric Resistivity (20°C) (μQ·cm)	TCR (0 to 50°C) (10 ⁻⁴ /°C)
		Temp. (°C)	Time (h)	Cooling Rate (°C/hr)			
1	Be 2.7	-	-	-	7.7	64.31	0.01
2	Mg 4.2	-	-	-	4.7	67.24	-0.02
3	Ca 5.8	-	-	-	5.8	71.38	0
4	Sr 9.6	550	16	100	9.6	72.15	0.43
5	Ba 7.9	800	12	150	7.9	76.36	0.03
6	Mn 12.4	-	-	-	3.8	106.88	-0.04
7	Fe 5.8	-	-	-	5.6	94.74	0.18
8	Co 7.4	-	-	-	5.4	97.74	-0.05
9	Ni 0.8	500	3	200	11.2	96.45	0.13
10	Mo 4.9	-	-	-	3.5	54.26	-0.09
11	W 1.5	-	-	-	9.3	55.87	0.09
12	Ti 0.5	-	-	-	10.6	60.03	0.71
13	V 1.0	-	-	-	9.4	62.04	0.08
14	Zr 2.3	450	24	100	7.9	57.44	0.35
15	Nb 0.9	-	-	-	11.2	56.87	0.07
16	Hf 2.8	-	-	-	6.7	71.45	0.48
17	Ta 1.6	500	10	80	8.3	69.66	-0.11
18	Ru 4.4	-	-	-	9.1	74.83	-0.13
19	Rh 6.0	500	6	100	8.0	73.92	0.06
20	Re 7.7	-	-	-	5.4	79.12	-0.02
21	Os 5.4	-	-	-	6.2	78.27	0.04
22	Ir 6.3	-	-	-	5.4	80.33	-0.05
23	Pt 7.2	-	-	-	5.7	71.25	0.09
24	Pd 12.9	-	-	-	3.9	70.30	0.11
25	Ag 5.8	-	-	-	6.2	72.96	0.09
26	Au 7.0	450	2	50	6.1	75.39	0.08
27	Y 2.9	500	60	80	8.2	73.41	0.12
28	La 5.1	-	-	-	5.7	73.39	0.01
29	Ce 3.8	-	-	-	6.6	73.05	0.04

[0037]

[Table 5]

Sample No.	Composition of Sub-Component (Cr as a balance)	Heat Treatment			Gauge Factor (20°C)	Specific Electric Resistivity (20°C) (μΩ·cm)	TCR (0 to 50°C) (10 ⁻⁴ /°C)
		Temp. (°C)	Time (h)	Cooling Rate (°C/hr)			
30	B 1.8	-	-	-	8.2	70.05	0.04
31	Al 2.3	-	-	-	12.4	70.90	-0.04
32	Ca 3.8	-	-	-	10.0	71.32	0.10
33	In 4.2	450	5	120	6.5	71.86	-0.01
34	Tl 4.7	-	-	-	6.6	75.99	-0.03
35	Cu 3.2	-	-	-	5.6	76.89	0.05
36	Zn 2.9	500	20	150	9.7	76.72	0.52
37	C 2.0	-	-	-	13.1	86.05	0.33
38	Si 3.2	-	-	-	11.7	91.45	-0.12
39	Ge 2.8	-	-	-	10.8	91.67	-0.56
40	Sn 7.8	-	-	-	9.1	89.22	-0.22
41	Pb 7.1	520	48	500	5.7	79.77	0
42	N 2.3	-	-	-	8.6	96.18	-0.05
43	P 2.7	-	-	-	8.1	80.63	-0.08
44	As 5.4	-	-	-	6.1	76.24	0.02
45	Sb 6.7	-	-	-	3.8	72.39	0.03
46	Bi 3.9	-	-	-	5.2	71.46	-0.11
47	Se 2.3	-	-	-	10.1	92.96	0.01
48	Te 2.9	400	72	10	6.2	81.32	-0.07
49	C 3.0, Al 1.3	-	-	-	8.4	108.54	0.76
50	C 3.0, Si 1.5	-	-	-	8.8	107.23	-0.76
51	C 3.0, Ni 0.4	-	-	-	8.0	106.94	-0.99
52	C 3.0, Nb 0.5	-	-	-	7.4	102.81	-0.63
53	Al 1.2, Si 1.6	-	-	-	7.9	99.36	-0.24
54	Al 1.2, Ni 0.4	500	24	200	7.9	96.28	-0.60
55	Al 1.2, Nb 0.4	-	-	-	7.5	95.04	-0.31
56	Si 1.6, Ni 0.4	-	-	-	7.6	102.39	0.13
57	Al 10, Si 4, Ni 1	-	-	-	6.9	112.72	0.84
58	Mo 22, Si 13, Sn 8	500	10	100	5.9	120.17	0.45

[0038]

[Advantages] The thin film of the Cr-base alloy of the invention has a small temperature coefficient of electric resistance at near room temperature, and the gauge factor thereof is remarkably large as compared with conventional materials. Since the strain gauge comprising the thin film for the strain gauge according to the invention has a gauge factor of 2 or more with a temperature coefficient of electric resistance of within (-3.5 to 3.5) × 10⁻⁴/°C, it is effective for exhibiting high sensitivity and high stability. Accordingly, the strain gauge comprising the thin film of the invention is suitable for a load cell, strain sensor, weighting level gauge, accelerometer, various stress-strain meters and various security instruments.

[Brief Description of Drawings]

[Fig. 1] Fig. 1 shows temperature dependence of electrical electric resistance of the Cr thin film.

[Fig. 2] Fig. 2 shows the temperature coefficient of electric resistance at 0 to 50°C and gauge factor at room temperature (20°C) against the amounts of Be, Mg, Ca, Sr and Ba added as sub-components.

[Fig. 3] Fig. 3 shows the temperature coefficient of electric resistance at 0 to 50°C and gauge factor at room temperature (20°C) against the amounts of Fe, Co, Mn and Al added as sub-components.

[Fig. 4] Fig. 4 shows the temperature coefficient of electric resistance at 0 to 50°C and gauge factor at room temperature (20°C) against the amounts of Ti, V, Zr, Nb, Hf, Ta, Ni, Ge, Si, C, N, P, Se and Te added as sub-components.

[Fig. 5] Fig. 5 shows the temperature coefficient of electric resistance at 0 to 50°C and gauge factor at room temperature (20°C) against the amounts of Ru, Rh, Re, Os, Ir, Pt and Pd added as sub-components.

[Fig. 6] Fig. 6 shows the temperature coefficient of electric resistance at 0 to 50°C and gauge factor at room temperature (20°C) against the amounts of Ag, Au, Y, La and Ce added as sub-components.

[Fig. 7] Fig. 7 shows the temperature coefficient of electric resistance at 0 to 50°C and gauge factor at room temperature (20°C) against the amounts of Pb, Sn, As, Sb, Bi, W, B, Ga, In, Tl, Cu and Zn added as sub-components.

[Fig. 8] Fig. 8 shows the relationship between the heating temperature, and the temperature coefficient of electric resistance, specific electric resistivity and gauge factor when the thin film of the alloy of sample No. 13 (composition: Cr-1.0% V) is subjected to a heat treatment in vacuum for 2 hours.

Fig.1

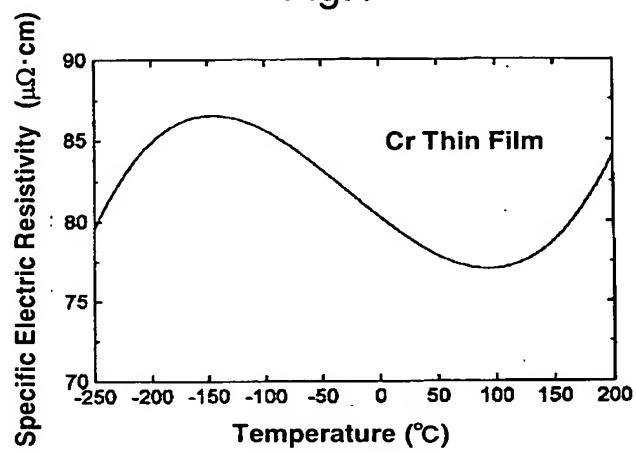


Fig.2

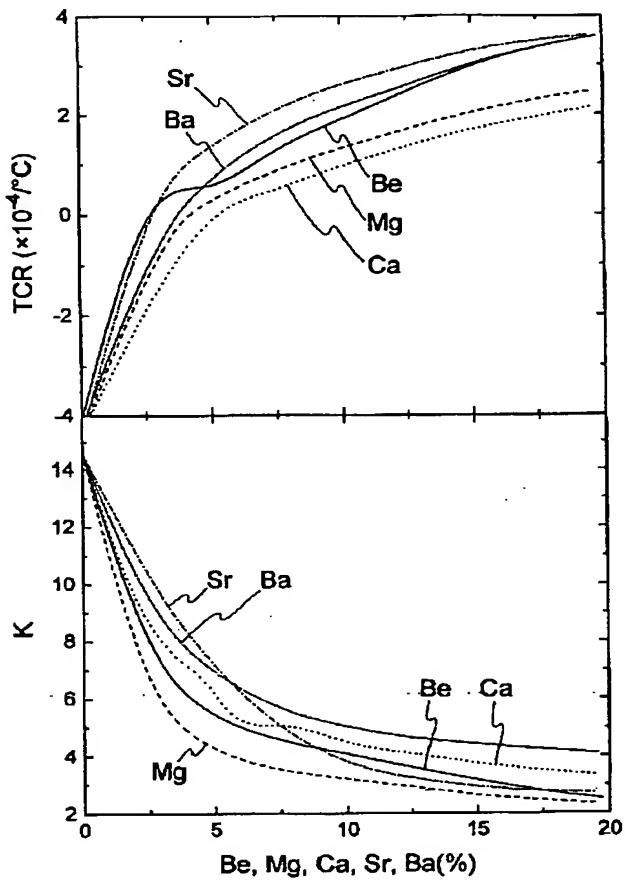


Fig.3

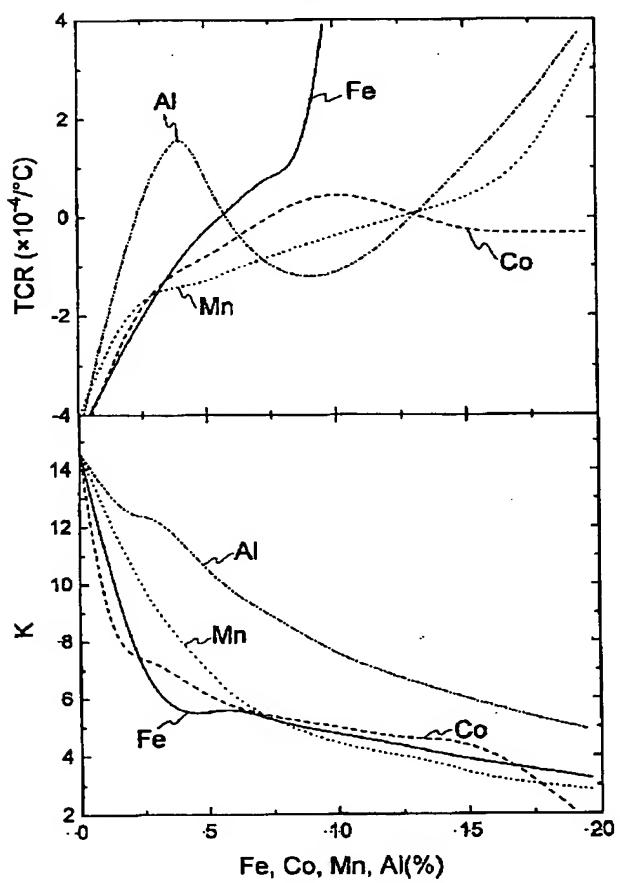


Fig.4

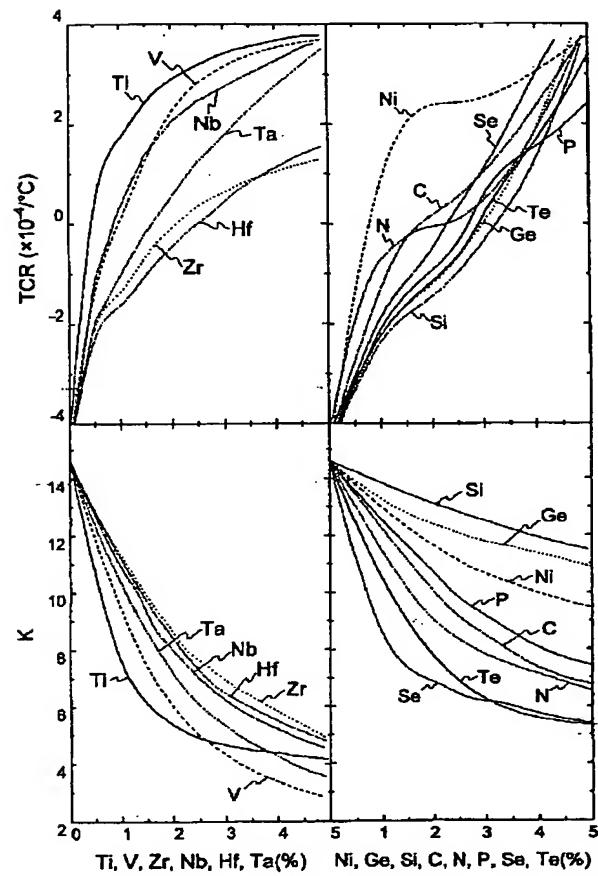


Fig.5

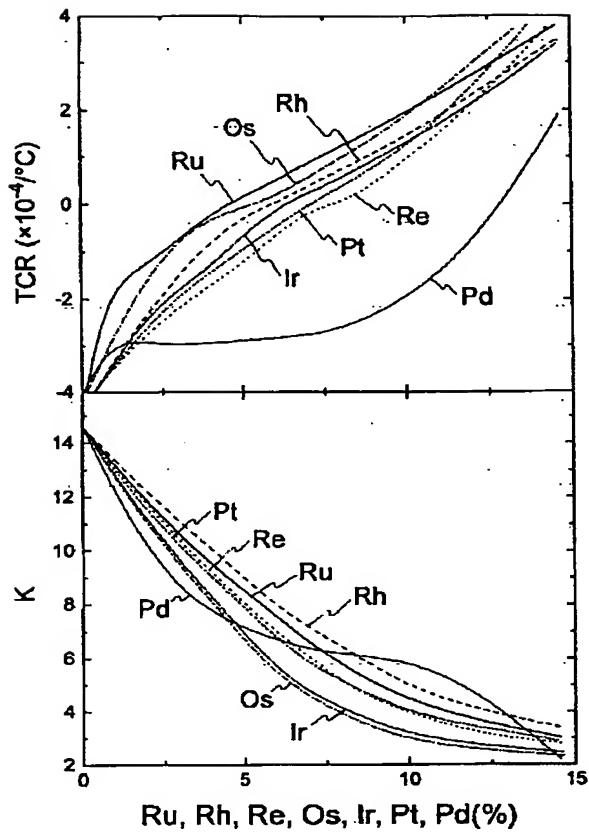


Fig.6

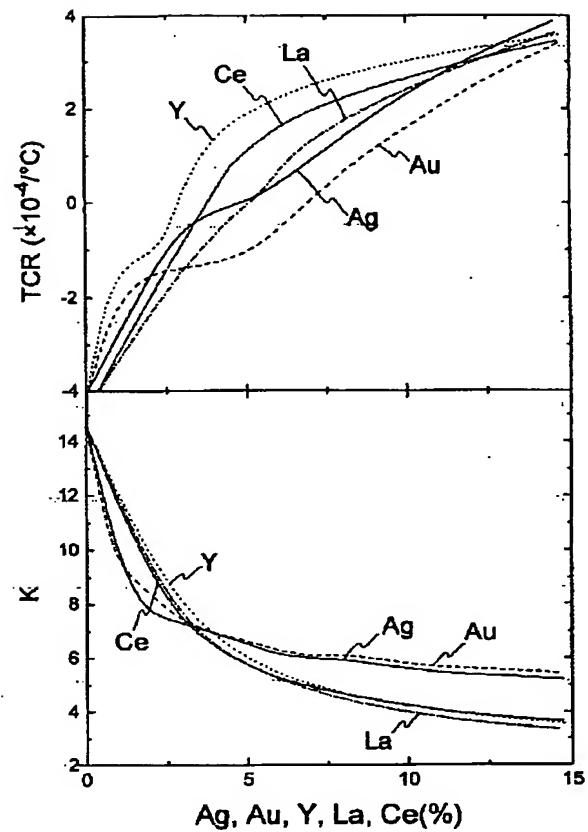


Fig.7

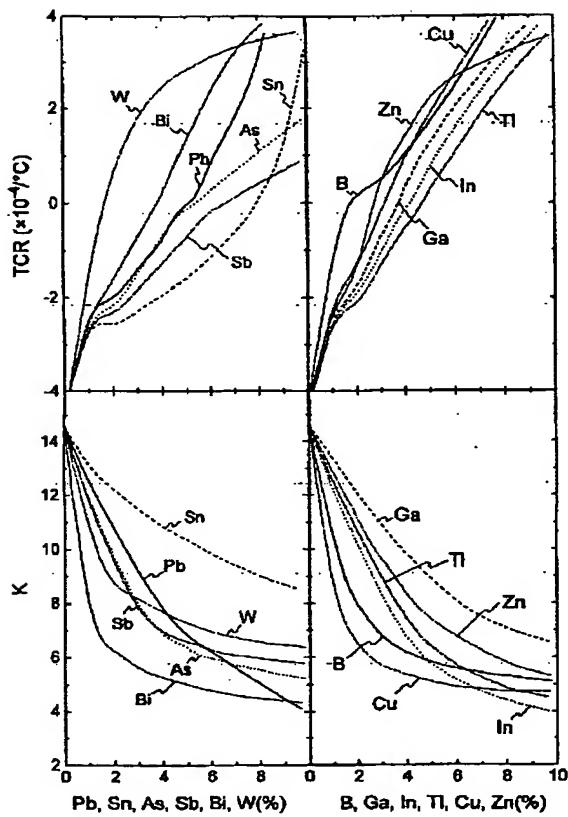
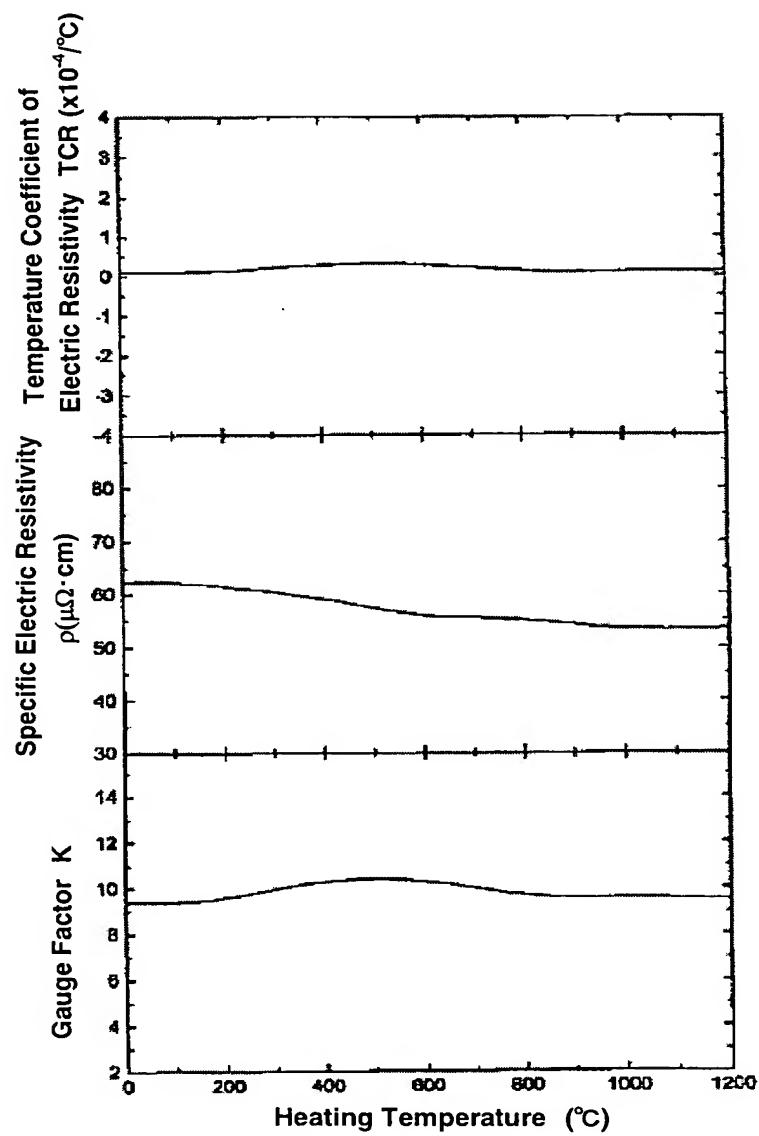


Fig.8



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-95751

(43)公開日 平成9年(1997)4月8日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
C 22 C	27/06		C 22 C	27/06
C 23 C	14/14		C 23 C	14/14
	30/00			D
G 01 B	7/16		G 01 L	1/22
G 01 L	1/22		G 01 B	7/18

審査請求 未請求 請求項の数7 書面 (全14頁)

(21)出願番号	特願平7-293228	(71)出願人	000173795 財団法人電気磁気材料研究所 宮城県仙台市太白区八木山南2丁目1-1
(22)出願日	平成7年(1995)10月3日	(72)発明者	丹羽 英二 宮城県仙台市太白区八木山南1丁目3-16

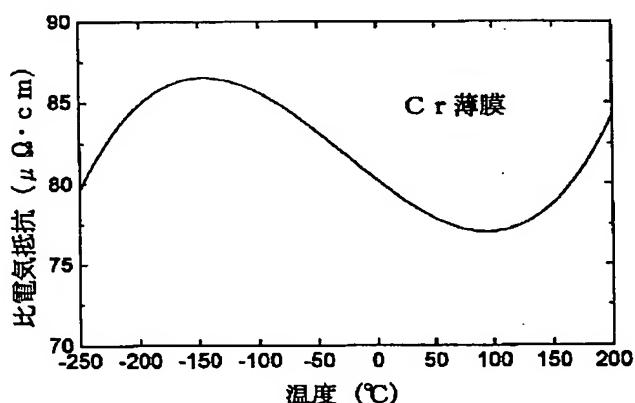
(72)発明者 佐々木 祥弘
宮城県柴田郡大河原町字広瀬町3-2
(72)発明者 増本 剛
宮城県仙台市太白区八木山南1丁目1-27

(54)【発明の名称】 Cr基合金薄膜およびその製造法ならびにストレインゲージ

(57)【要約】

【目的】 本発明は、Crと所要の副成分からなり、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5)×10-4/°C以内であるCr基合金薄膜およびその製造法を提供するにある。また、前記合金薄膜よりなるストレインゲージを提供するにある。

【構成】 原子%にて、Cr(残部)を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなり、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5)×10-4/°C以内であることを特徴とするストレインゲージ用Cr基合金薄膜。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 原子%にて、Cr（残部）を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素それぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなり、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 以内であることを特徴とするストレインゲージ用Cr基合金薄膜。

【請求項2】 導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr（残部）を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなる薄膜を、蒸着またはスパッタリング等で成膜することにより、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 以内であることを特徴とするストレインゲージ用Cr基合金薄膜の製造法。

【請求項3】 導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr（残部）を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなる薄膜を、蒸着またはスパッタリング等により成膜し、さらに非酸化性ガス、還元性ガスまたは真空中の100°C以上1200°C以下の温度で加熱後冷却することにより、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 以内であることを特徴とするストレインゲージ用Cr基合金薄膜の製造法。

【請求項4】 導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr（残部）

を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなり、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 以内であるCr基合金薄膜からなることを特徴とするストレインゲージ。

【請求項5】 導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr（残部）を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなり、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 以内であるCr基合金薄膜の上部または下部に金属電極を形成することを特徴とするストレインゲージ。

【請求項6】 導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr（残部）を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなる薄膜を、蒸着またはスパッタリング等により成膜し、さらに非酸化性ガス、還元性ガスまたは真空中の100°C以上1200°C以下の温度で加熱後冷却することにより、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 以内であるCr基合金薄膜からなることを特徴とするストレインゲージ。

【請求項7】 導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr（残部）を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Te

のそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tiのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなる薄膜を、蒸着またはスパッタリング等により成膜し、さらに非酸化性ガス、還元性ガスまたは真空中の100°C以上1200°C以下の温度で加熱後冷却することにより、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5) × 10⁻⁴/°C以内であるCr基合金薄膜の上部もしくは下部に金属電極を形成することを特徴とするストレインゲージ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、Cr(クロム)を主成分とし、副成分としてTi(チタン)、V(バナジウム)、Nb(ニオブ)、Ta(タンタル)、Ni(ニッケル)、Zr(ジルコニウム)、Hf(ハフニウム)、Si(ケイ素)、Ge(ゲルマニウム)、C(炭素)、N(窒素)、P(リン)、Se(セレン)、Te(テルル)、Fe(鉄)、Mo(モリブデン)、W(タンゲステン)、As(ヒ素)、Sn(スズ)、Sb(アンチモン)、Pb(鉛)、Bi(ビスマス)、Al(アルミニウム)、B(ホウ素)、Ga(ガリウム)、In(インジウム)、Ti(タリウム)、Cu(銅)、Zn(亜鉛)、Mn(マンガン)、Ru(ルテニウム)、Rh(ロジウム)、Re(レニウム)、Os(オスミウム)、Ir(イリジウム)、Pt(白金)、Pd(パラジウム)、Ag(銀)、Au(金)、希土類元素、Co(コバルト)、Be(ベリリウム)、Mg(マグネシウム)、Ca(カルシウム)、Sr(ストロンチウム)およびBa(バリウム)のうち1元素または2元素以上の合計0.001~50%とからなるCr基合金薄膜およびその製造法ならびにこの合金薄膜を使用したストレインゲージに関するもので、その目的とするところはゲージ率(抵抗ひずみ感度)が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5) × 10⁻⁴/°C以内である合金薄膜を提供するにある。また、前記合金薄膜よりなるストレインゲージを提供するにある。

【0002】

【従来の技術】ストレインゲージは、一般に弾性ひずみによって細線または箔形状のゲージ材の電気抵抗が変化する現象を利用するものであるが、逆に抵抗変化を測定することにより、ひずみや応力の計測ならびに変換に用いられる。例えば、生産工業におけるひずみ計、重量計、加速度計および各種力学量-電気量変換機器、土木工業における土圧計、建築業・エネルギー関連業における圧力計および撓み量計、航空・宇宙・鉄道・船舶関連

業における各種応力・ひずみ計等に広く利用されており、さらに民生用としての商用秤およびセキュリティ機器等にも多く利用されている。

【0003】ストレインゲージは、その構造が金属細線(10~30μm)または金属箔(3~5μm)をグリッド状あるいはロゼット状に配置してなり、またその使用法としては前記ゲージを被測定物に接着剤で貼り付けし、被測定物に生じたひずみをゲージの抵抗変化から間接的に測定するものである。ストレインゲージの感度は、ゲージ率Kによって決まり、Kの値は一般に次の式で与えられる。

【0004】

【数1】

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta \ell/\ell} = 1 + 2\sigma + \frac{\Delta \rho/\rho}{\Delta \ell/\ell}$$

【0005】ここで、R、σ、ρおよびℓはそれぞれゲージ細線または箔の全抵抗、ボアン比、比電気抵抗および全長である。一般に、金属・合金におけるσはほぼ0.3であるから、前記の式における右辺第1項と第2項の合計は約1.6でほぼ一定の値となる。したがってゲージ率を大きくするためには、前記の式における第3項が大きいことが必須条件である。すなわち、材料に引っ張り変形を与えたとき材料の長さ方向の電子構造が大幅に変化し、比電気抵抗の変化量Δρ/ρが増加することによる。

【0006】ゲージ率が大きな材料には半導体の炭素、ケイ素およびゲルマニウム等が知られている。しかしこれら半導体の場合、ゲージ率は10~170と非常に大きいが、その値の異方性および温度による変動が大きく安定性にも欠け、さらに機械的強度が劣る等の欠点を有することから、特殊な小型圧力変換機器に応用されるにとどまっている。ストレインゲージ用材料として現在最も多く使用されている材料は、Cu-Ni合金である。この合金は抵抗温度係数がきわめて小さいため、温度変化に対する特性の変動が小さという特徴を有しているが、その反面、ゲージ率は2と小さく、さらに高感度なストレインゲージ用材料としては適していない。

【0007】合金材料を用いたストレインゲージは、上で述べたように細線もしくは箔の形で使用される。しかし、細線形状のストレインゲージは、グリッド形成時の残留ひずみの影響および加工した細線材と基板を密着させるために用いる接着剤の影響等により特性にばらつきが大きく、しかもグリッドの形成や細線材と基板の接着といった特殊技術が必要なため、生産効率が悪くコスト高の原因となっている。また、箔形状のストレインゲージは、加工時のひずみの影響はないが、接着剤の影響については細線材と同様であり、これも問題となっている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】ストレインゲージの応用領域は、近年のマイクロコンピューターの進歩に伴つてますます拡大し、小型化および高性能化に向かっている。特に、高感度で安定性を必要とする圧力変換器やロードセルの他、ロボットの接触センサや滑りセンサ等に使用可能なストレインゲージの要求が高まってきた。これらの各種センサ用ストレインゲージに関して、高感度で良好な安定性を有する素材の開発ならびに製造工程の改良が緊急に求められている。

【0009】本発明が解決しようとする課題は、既に市販されているストレインゲージのゲージ率2を上回り、且つ実用上 $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 以内が望ましいとされている抵抗温度係数の小さい薄膜材料とその製造法を開発するにある。本発明においては、高感度で良好な安定性を有する素材として構造上安定な金属材料に対象を絞り、その中からゲージ率の高い素材としてCrに着目した。

【0010】Crのバルク（塊状）の抵抗ひずみ感度は26～28と非常に大きいことが知られている。しかし、Crは加工が非常に困難であることから、これまで細線および箔形状のストレインゲージに用いることはできなかった。そこで加工を必要としない薄膜化によって、Crをストレインゲージに応用することが考えられる。Cr薄膜のゲージ率はバルクほどではないが14.8と大きい。しかしストレインゲージは通常室温で使用されるので、室温における抵抗変化量が小さいことが必要であるが、図1に示すとおり、Cr薄膜の室温における抵抗温度係数は負の値で大きく $(-6 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C})$ 、安定性の点でストレインゲージに適していない。

【0011】そこで本発明は、Cr薄膜の高いゲージ率をできるだけ保持しながら、抵抗温度係数を小さくすることによって、優れた高感度で高安定なストレインゲージ用薄膜を得ることを目的としてなされたものである。

【0012】

【発明が解決するための手段】本発明は、図1に見られるように比電気抵抗値の温度変化における極小または極大の領域で抵抗変化が小さいことに着目し、この領域を室温に移動する方法について検討した。すなわちバルクのCrのネール点の温度（ネール温度）は特定の元素を添加することによって低温側または高温側に移動することが知られている。そこで極小および極大はネール点と緊密な関連があるものと考え、Crに副成分として種々の元素を添加し、その添加量と極小および最大の領域の移動幅との関係について調べる実験を鋭意行った。その結果、適当な量の副成分元素をCrに加えることによって、室温近傍に極大または極小の領域をもたらすことができ、これによって室温における抵抗温度係数を小さくできることが明らかとなった。

【0013】

また、室温以外の温度でストレインゲージを使用する場合にも、Crに加える元素の種類と量を適

当に選択することによって、所望の温度領域において抵抗温度係数が小さいストレインゲージを提供することが可能であることが判明した。

【0014】これらの知見のもとに、さらに幾多の実験を行った結果、原子%にて、Cr（残部）を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、Al、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10以下、Mn、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Baのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01～50%と少量の不純物からなり、室温付近でゲージ率が大きく、抵抗温度係数の小さいCr基合金薄膜が得られ、高感度ストレインゲージ用材料として適していることを見出したことである。

【0015】本発明を製造するには、上記組成の合金を原料とした蒸着、または上記組成の薄膜の形成が可能な合金ターゲット、複合ターゲットまたは多元ターゲットを用いたスパッタリング、もしくは上記組成の薄膜の形成が可能な原料を用いた気相輸送法等により、導電性基板上に絶縁体膜を形成した上または絶縁性基板上にマスク法などを用いて所望の形状および、厚さの薄膜を形成する。または適当な形状の薄膜を形成した後、ドライエッティング（プラズマエッティング、スパッタエッティング等）、化学エッティング（腐食法）、レーザトリミング法などのエッティングまたはトリミング加工などを施すことにより所望の形状に加工し、素子となす。また必要ならば温度補償として、前記素子と直角に配置した素子を同一面内に構築したゲージパターンを形成する。さらにこのまで使用するか、または必要ならばこれに電極を構築し、さらに必要ならばこれらの薄膜を大気中、非酸化性ガス中、還元性ガス中または真空中の100°C以上1200°C以下の温度で、適当な時間、好ましくは1秒間以上100時間以下加熱後、適度な速度で、好ましくは1°C/時以上100°C/分以下の速度で冷却することによって、抵抗ひずみ感度（ゲージ率）が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 以内の値を有するストレインゲージ用Cr基合金薄膜が得られる。

【0016】第1発明

原子%にて、Cr（残部）を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Al

のそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなり、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5)×10-4/°C以内であることを特徴とするストレインゲージ用Cr基合金薄膜。

【0017】第2発明

導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板状に、原子%にて、Cr(残部)を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ca、In、Tiのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなる薄膜を、蒸着またはスパッタリング等で成膜することにより、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5)×10-4/°C以内とすることを特徴とするストレインゲージ用Cr基合金薄膜の製造法。

【0018】第3発明

導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr(残部)を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tiのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなる薄膜を、蒸着またはスパッタリング等により成膜し、さらに非酸化性ガス、還元性ガスまたは真空中の100°C以上1200°C以下の温度で加熱後冷却することにより、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5)×10-4/°C以内とすることを特徴とするストレインゲージ用Cr基合金薄膜の製造法。

【0019】第4発明

導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr(残部)を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tiのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元

素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなり、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5)×10-4/°C以内であるCr基合金薄膜からなることを特徴とするストレインゲージ。

【0020】第5発明

導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr(残部)を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tiのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなり、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5)×10-4/°C以内であるCr基合金薄膜の上部または下部に金属電極を形成することを特徴とするストレインゲージ。

【0021】第6発明

導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr(残部)を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tiのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなる薄膜を、蒸着またはスパッタリング等により成膜し、さらに非酸化性ガス、還元性ガスまたは真空中の100°C以上1200°C以下の温度で加熱後冷却することにより、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が(-3.5~3.5)×10-4/°C以内であるCr基合金薄膜からなることを特徴とするストレインゲージ。

【0022】第7発明

導電性基板上に絶縁体膜を形成した上に、または絶縁性基板上に、原子%にて、Cr(残部)を主成分とし、副成分としてTi、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tiのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01~50%と少量の不純物からなる

薄膜を、蒸着またはスパッタリング等により成膜し、さらに非酸化性ガス、還元性ガスまたは真空中の100°C以上1200°C以下の温度で加熱後冷却することにより、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$ 以内であるCr基合金薄膜の上部もしくは下部に金属電極を形成することを特徴とするストレインゲージ。

【0023】

【作用】図1からわかるように、極小および極大の領域の温度は、それぞれ約90°Cおよび-150°Cである。これらの温度領域を室温に移動させ、室温における抵抗温度係数を小さくするために、ネール温度を低温側に移動させる働きをもつ元素によって極小領域を適用する場合と高温側に移動させる働きをもつ元素によって極大領域を適用する場合の両方法が可能であると考えられる。

【0024】図2～7には、高周波スパッタリング装置を用いてガラス基板上に成膜した試料について、各元素の添加量と、0～50°Cにおける抵抗温度係数および室温(約20°C)におけるゲージ率との関係を示す。これらの図からわかるように、Ti、V、Nb、Ta、Ni、Zr、Hf、Si、Ge、C、N、P、Se、Teのそれぞれ5%以下、Zn、Cu、Biのそれぞれ8%以下、Fe、Mo、W、As、Sn、Sb、Pb、B、Ga、In、Tlのそれぞれ10%以下、Ru、Rh、Re、Os、Ir、Pt、Pd、Ag、Au、希土類元素のそれぞれ15%以下、Co、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Alのそれぞれ20%以下のうち1元素または2元素以上の合計0.01～50%、好ましくは0.1～40%、さらに好ましくは1～40%および残部Crと、それぞれの範囲に限定した理由は、これらの範囲ではゲージ率が2以上の高い値が得られ、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$ 以内の小さい値が得られるからであり、これらの範囲外では、これらの効果が期待できないからである。

【0025】上記副成分のうち、Hf、Zr、P、As、Sb、Mg、Ca、CoおよびPdについては、限定の範囲を超えて抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$ 以内を示すが、HfとZrは、5%を越えると薄膜表面の荒れがひどく特性がまったく安定せず、また、PおよびAsとSbならびにMgとCaはそれぞれ、5%および10%ならびに20%を越えると膜が基板から剥離してしまい、さらに、PdおよびCoはそれぞれ15%および20%を越えると、ゲージ率が2よりも小さくなってしまうので、ストレインゲージに適用することができず、したがって、これらの元素に対して上記限定をもうけた。

【0026】図2～7から、ゲージ率は副成分の添加量の増加に伴って減少することがわかるが、C、Si、Ge、AlおよびGaは、副成分の添加量の増加に対しゲ

ージ率の減少が小さく、また、Ni、NbおよびTiは、それら副成分を少量添加するだけで極小点が室温に移動するので、高いゲージ率を得ることができる。これらの高いゲージ率を得ることができる元素を複数加えた場合は高いゲージ率が得られ、また、本発明の副成分のうちから2元素以上を加えた場合、すべて2より大きなゲージ率の値が得られた。

【0027】なお、希土類元素はSc、Yおよびランタン系元素(La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、YbおよびLu)からなるが、その効果は均等であり、いずれも同効成分である。

【0028】図8は、加熱温度と本発明合金(試料番号:13)の抵抗温度係数、比抵抗およびゲージ率との関係を示す。図に見られるように、本発明合金を100°C以上1200°C以下の温度範囲において、1分間以上100時間以下加熱し、ついで1°C/時以上1000°C/分以下の速度で冷却することにより、所期のゲージ特性が得られる。熱処理の条件において、100°C以上1200°C以下の温度範囲において、好ましくは1分間以上100時間以下加熱するように限定した理由は、この処理条件内ではゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$ 内になってほしいからである。100°C以下ではゲージ特性に変化が見られず、工程上無駄になるので経済的に好ましくない。また1200°C以上では、所期のゲージ特性が得られず好ましくない。

【0029】

【実施例】本発明の実施例について説明する。

実施例1 試料番号7(組成:Cr-5.8%Fe)の合金薄膜の製造と評価
直径105mmおよび厚さ3mmのCrの円盤(純度99.9%)を銅製電極にボンディングし、さらにCrの上に面積 $7 \times 7 \text{ mm}^2$ および厚さ0.8mmの大きさの板状Feチップ(純度99.9%)を4枚ボンディングしてスパッタ用複合ターゲットとする。この複合ターゲットからマグネットロン方式高周波スパッタリング装置を用いて、下記に示したスパッタリング条件で厚さ0.36μmの薄膜を作製する。基板には成膜前にガラス製のマスクをかぶせておき、成膜時にパターン化した薄膜を形成できるようにする。

予備排気	$1 \times 10^{-7} \text{ Torr}$
高周波電力	100W
アルゴンガス圧	$1 \times 10^{-2} \text{ Torr}$
基板	ガラス(CORNING #0211)
基板温度	非加熱
電極間距離	50mm
成膜速度	30 \AA/min
作製した薄膜にハンダを用いて直径0.05mmの被服	

導線を溶接して電極となし、4端子法にて抵抗温度係数およびゲージ率の測定を行った。その結果、表1に示したとおり、 $0.18 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ の非常に小さい抵抗温度係数と5.6のゲージ率が得られた。次に得られた薄膜を、各種雰囲気中 $100^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ の各種温度で適当時間加熱後室温まで炉中冷却（冷却速度： $200^{\circ}\text{C}/\text{時間}$ ）した。表1は、それら熱処理の方法と、熱処理

後の抵抗温度係数、比抵抗およびゲージ率を示す。いずれの雰囲気においてもゲージ率は改善され、大きな値を示した。熱処理温度の上昇に伴って抵抗温度係数は若干大きくなつたが、ストレインゲージとして安定性に支障をきたすほどではなかった。

【0030】

【表1】

熱処理			ゲージ率K (20°C)	比電気抵抗 (20°C) ($\mu\Omega \cdot \text{cm}$)	抵抗温度係数 ($0 \sim 50^{\circ}\text{C}$) ($\times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$)
雰囲気	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	時間 (h)			
as-depo	-	-	5.6	94.74	0.18
大気中	400	10	8.1	90.47	0.42
H ₂ 気流中	450	5	7.9	88.72	0.52
真空中	500	30	8.3	91.56	0.40
真空中	200	80	7.2	92.94	0.29

【0031】実施例2 試料番号13（組成：Cr—1.0%V）の合金薄膜の製造と評価

純度99.9%のCrおよびVをアーキメルト法によって合金化し、直径203mmおよび厚さ5mmの合金ターゲットを作製する。その合金ターゲットを銅製電極にボンディングしてスパッタ用ターゲットとする。このターゲットからイオンビームスパッタリング装置を用いて、下記に示したスパッタリング条件で厚さ $0.36\text{ }\mu\text{m}$ の薄膜を作製する。基板には成膜前にガラス製のマスクをかぶせておき、成膜時にゲージパターンを形成できるようにし、さらにNiおよびAuの積層電極を構築する

予備排気	$2 \times 10^{-8}\text{ Torr}$
加速電圧	700V
イオン電流密度	2 mA/cm^2
基板	表面にSiO ₂ 絶縁膜を形成したス
テンレス	
基板温度	500°C
イオン源—ターゲット間距離	120mm
基板—ターゲット間距離	120mm
成膜速度	90 \AA/min

作製した薄膜の電極にAu線を溶接し、4端子法にて抵抗温度係数およびゲージ率の測定を行った。その結果、 $0.08 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ の非常に小さい抵抗温度係数と9.4の非常に大きなゲージ率が得られた。次に得られた薄膜に対して、各種雰囲気中 $100^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$ の各種温度で適当時間加熱後室温まで炉中冷却（冷却速度： $50^{\circ}\text{C}/\text{時間}$ ）した。表2は、それら熱処理の方法と熱処理後の抵抗温度係数、比抵抗およびゲージ率を示す。いずれの雰囲気においてもゲージ率は改善され、大きな値を示した。図8は、これら熱処理を真空中2時間の条件で施した場合の加熱温度と抵抗温度係数、比抵抗およびゲージ率との関係を示す。ゲージ率は約 500°C で極大値を示し、また、比抵抗は加熱温度の上昇とともに小さくなつて行くが、抵抗温度係数はこれも約 500°C 付近で極大値を示した。この熱処理による抵抗温度係数の増加分は $0.3 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$ 程度と小さく、ゲージ率の増大の方がより顕著であるので、高感度で高安定なストレインゲージを製造する上で本発明の熱処理は有効である。

【0032】

【表2】

熱処理			ゲージ率K (20°C)	比電気抵抗 (20°C) (μΩ・cm)	抵抗温度係数 (0~50°C) (×10 ⁻⁴ /°C)
雰囲気	温度 (°C)	時間 (h)			
as-depo	-	-	9.4	62.04	0.08
大気中	450	10	10.1	58.7	0.32
N ₂ 気流中	500	5	10.1	59.3	0.25
真空中	400	30	10.4	54.3	0.32
真空中	800	80	9.6	60.2	0.09

【0033】実施例3 試料番号53（組成：Cr—1.2%Al—1.6%Si）の合金薄膜の製造と評価
純度99.99%のCr、純度99.9%のAlおよび純度99.99%のSiを、それぞれ97.0%、1.3%および1.7%を高周波溶解炉により溶解して合金化し、そのうち約1gを蒸発源原料とする。この原料を用いて、真空蒸着装置中において下記の条件のもと真空蒸着によって厚さ1.2μmの薄膜を作製する。基板には成膜前に金属製のマスクをかぶせておき、成膜時にゲージパターンを形成できるようにする。

真空度 6 × 10⁻⁷ Torr

基板 ポリイミド（厚さ0.1mm）

基板温度 200°C

基板—蒸発源間距離 180mm

成膜速度 130 Å/min

作製した薄膜を真空蒸着装置から取り出し、基板を覆う

マスクを交換した後再び真空蒸着装置にて電極用のCu

膜を形成し、ハンダを用いて直径0.2mmの被服導線を溶接して4端子法にて抵抗温度係数およびゲージ率の測定を行った。その結果、-0.24 × 10⁻⁴/°Cの小さい抵抗温度係数と7.9の大きなゲージ率が得られた。次に得られた薄膜に対して、各種雰囲気中100°C～400°Cの各種温度で適当時間加熱後室温まで炉中冷却（冷却速度：500°C/時間）した。表3は、それら熱処理の方法と、熱処理後の抵抗温度係数、比抵抗およびゲージ率を示す。実施例1と同様、いずれの雰囲気においてもゲージ率は改善され、大きな値を示した。また、これも同様に熱処理温度の上昇に伴って抵抗温度係数は若干大きくなつたが、ストレインゲージとして安定性に支障をきたすほどではなかった。すなわち、本発明合金を使用することによって高感度・高安定性ストレインゲージを提供できることが明らかになった。

【0034】

【表3】

熱処理			ゲージ率K (20°C)	比電気抵抗 (20°C) (μΩ・cm)	抵抗温度係数 (0~50°C) (×10 ⁻⁴ /°C)
雰囲気	温度 (°C)	時間 (h)			
as-depo	-	-	7.9	99.36	-0.24
大気中	330	10	9.1	96.21	0.22
H ₂ 気流中	400	5	9.4	94.33	0.31
真空中	380	30	8.3	96.87	0.30
真空中	280	80	8.1	97.92	0.15

【0035】表4および表5は、高周波スパッタリング装置を用いて表面にSiO₂絶縁膜を形成したステンレスの基板上に成膜したそのままの試料、またはそれらに種々の条件で熱処理を施した試料についての、本発明の

代表的な合金薄膜の抵抗温度係数（TCR）、比電気抵抗（ρ）およびゲージ率（K）の測定結果を示す。

【0036】

【表4】

試料番号	副成分の組成(%) (残鉄Cr)	熱処理			ゲージ率 (20°C)	比抵抗 (20°C) ($\mu\Omega \cdot \text{cm}$)	T C R (0~50°C) ($10^{-4}/^\circ\text{C}$)
		温度 (°C)	時間 (時)	冷却速度 (°C/時)			
1	Be 2.7	-	-	-	7.7	64.31	0.01
2	Mg 4.2	-	-	-	4.7	67.24	-0.02
3	Ca 5.8	-	-	-	5.8	71.38	0
4	Sr 9.6	550	16	100	9.6	72.15	0.43
5	Ba 7.9	600	12	150	7.9	76.36	0.03
6	Mn 12.4	-	-	-	3.8	106.88	-0.04
7	Fe 5.8	-	-	-	5.6	94.74	0.18
8	Co 7.4	-	-	-	5.4	97.74	-0.05
9	Ni 0.8	500	3	200	11.2	96.45	0.13
10	Mo 4.9	-	-	-	3.5	54.26	-0.09
11	W 1.6	-	-	-	9.3	55.87	0.09
12	Ti 0.5	-	-	-	10.6	60.03	0.71
13	V 1.0	-	-	-	9.4	62.04	0.08
14	Zr 2.3	450	24	100	7.9	57.44	0.35
15	Nb 0.9	-	-	-	11.2	56.87	0.07
16	Hf 2.8	-	-	-	6.7	71.45	0.48
17	Ta 1.6	500	10	80	8.3	69.66	-0.11
18	Ru 4.4	-	-	-	9.1	74.83	-0.13
19	Rh 6.0	500	5	100	8.0	73.92	0.06
20	Re 7.7	-	-	-	5.4	79.12	-0.02
21	Os 5.4	-	-	-	6.2	78.27	0.04
22	Ir 6.3	-	-	-	5.4	80.33	-0.05
23	Pt 7.2	-	-	-	5.7	71.25	0.09
24	Pd 12.9	-	-	-	3.9	70.30	0.11
25	Ag 5.8	-	-	-	6.2	72.96	0.09
26	Au 7.0	450	2	50	6.1	75.39	0.08
27	Y 2.9	500	60	80	8.2	73.41	0.12
28	La 6.1	-	-	-	5.7	73.39	0.01
29	Ce 3.8	-	-	-	6.6	73.05	0.04

【0037】

【表5】

試料番号	副成分の組成(%) (残部Cr)	熱処理			ゲージ率 (20°C)	比抵抗 (20°C) ($\mu\Omega \cdot \text{cm}$)	T C R (0~50°C) ($10^{-4}/^\circ\text{C}$)
		温度 (°C)	時間 (時)	冷却速度 (°C/時)			
3 0	B 1.8	-	-	-	8.2	70.05	0.04
3 1	Al 2.3	-	-	-	12.4	70.90	-0.04
3 2	Ge 3.8	-	-	-	10.0	71.32	0.10
3 3	In 4.2	450	5	120	6.5	71.86	-0.01
3 4	Tl 4.7	-	-	-	6.6	75.99	-0.03
3 5	Cu 3.2	-	-	-	5.6	76.89	0.05
3 6	Zn 2.9	500	20	150	9.7	76.72	0.52
3 7	C 2.0	-	-	-	13.1	86.06	0.33
3 8	Si 3.2	-	-	-	11.7	91.45	-0.13
3 9	Ge 2.8	-	-	-	10.8	91.67	-0.56
4 0	Sn 7.8	-	-	-	9.1	89.22	-0.22
4 1	Pb 7.1	520	48	500	6.7	79.77	0
4 2	N 2.2	-	-	-	8.6	96.18	-0.05
4 3	P 2.7	-	-	-	8.1	80.63	-0.08
4 4	As 5.4	-	-	-	6.1	76.24	0.02
4 5	Sb 6.7	-	-	-	3.8	72.39	0.03
4 6	Bi 3.9	-	-	-	5.2	71.46	-0.11
4 7	Se 2.3	-	-	-	10.1	92.96	0.01
4 8	Te 2.9	400	72	10	6.2	81.32	-0.07
4 9	C 3.0, Al 1.3	-	-	-	8.4	108.54	0.76
5 0	C 3.0, Si 1.5	-	-	-	8.8	107.23	-0.76
5 1	C 3.0, Ni 0.4	-	-	-	8.0	106.94	-0.99
5 2	C 3.0, Nb 0.6	-	-	-	7.4	102.81	-0.63
5 3	Al 1.2, Si 1.6	-	-	-	7.9	99.36	-0.24
5 4	Al 1.2, Ni 0.4	500	24	200	7.9	96.28	-0.60
5 5	Al 1.2, Nb 0.4	-	-	-	7.5	95.04	-0.31
5 6	Si 1.6, Ni 0.4	-	-	-	7.6	102.39	0.13
5 7	Al10, Si4, Ni1	-	-	-	6.9	112.72	0.84
5 8	Mn22, Si13, Sn8	500	10	100	5.9	120.17	0.45

【0038】

【発明の効果】本発明のCr基合金薄膜は室温付近で抵抗温度係数が小さく、且つ従来の材料よりもゲージ率が格段に大きい。すなわち、本発明のストレインゲージ用薄膜よりなるストレインゲージは、ゲージ率が2以上で、且つ抵抗温度係数が $(-3.5 \sim 3.5) \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$ 以内であるので、高感度・高安定性を発揮する効果がある。したがって、本発明の薄膜よりなるストレインゲージは、ロードセル、ストレインセンサ、重量計、加速度計、各種応力・歪計および各種セキュリティ機器等に好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、Cr薄膜の電気抵抗の温度依存性を示す。

【図2】図2は、副成分として加えるBe、Mg、Ca、SrおよびBaの量に対する0~50°Cにおける抵抗温度係数および室温(20°C)におけるゲージ率を示す。

【図3】図3は、副成分として加えるFe、Co、MnおよびAlの量に対する0~50°Cにおける抵抗温度係

数および室温(20°C)におけるゲージ率を示す。

【図4】図4は、副成分として加えるTi、V、Zr、Nb、Hf、Ta、Ni、Ge、Si、C、N、P、SeおよびTeの量に対する0~50°Cにおける抵抗温度係数および室温(20°C)におけるゲージ率を示す。

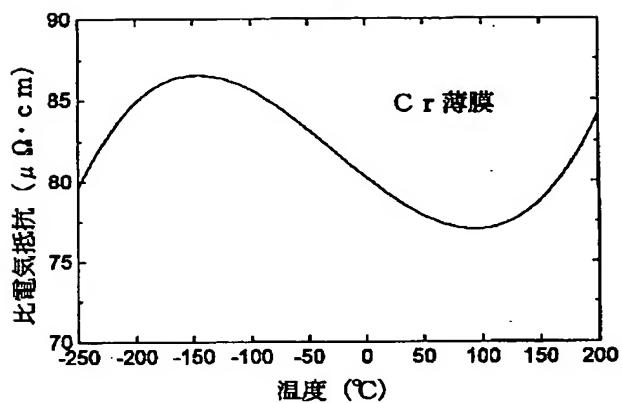
【図5】図5は、副成分として加えるRu、Rh、Re、Os、Ir、PtおよびPdの量に対する0~50°Cにおける抵抗温度係数および室温(20°C)におけるゲージ率を示す。

【図6】図6は、副成分として加えるAg、Au、Y、LaおよびCeの量に対する0~50°Cにおける抵抗温度係数および室温(20°C)におけるゲージ率を示す。

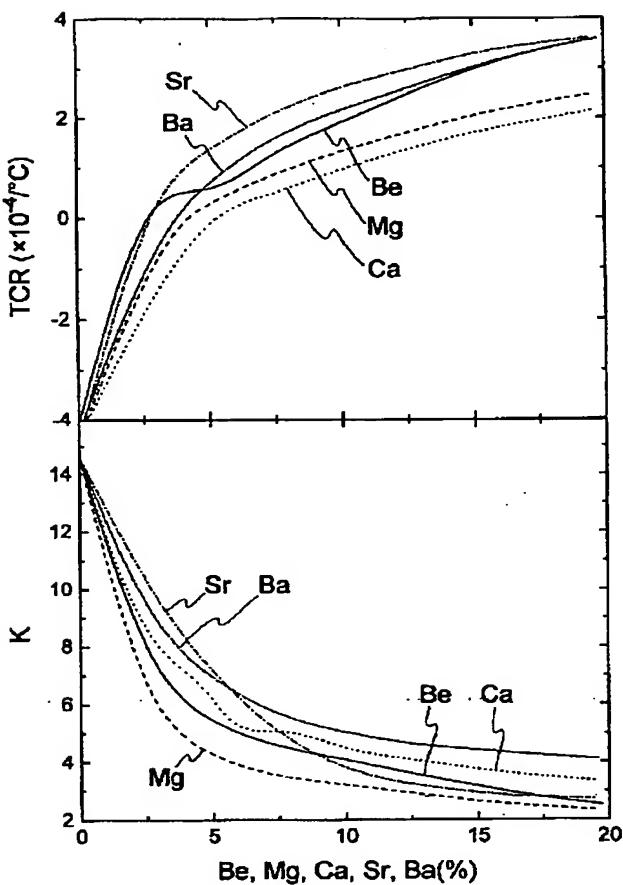
【図7】図7は、副成分として加えるPb、Sn、As、Sb、Bi、W、B、Ga、In、Tl、CuおよびZnの量に対する0~50°Cにおける抵抗温度係数および室温(20°C)におけるゲージ率を示す。

【図8】図8は、試料番号13(組成: Cr-1.0%V)の合金薄膜に真空中2時間の熱処理を施した場合の加熱温度と抵抗温度係数、比抵抗およびゲージ率との関係を示す。

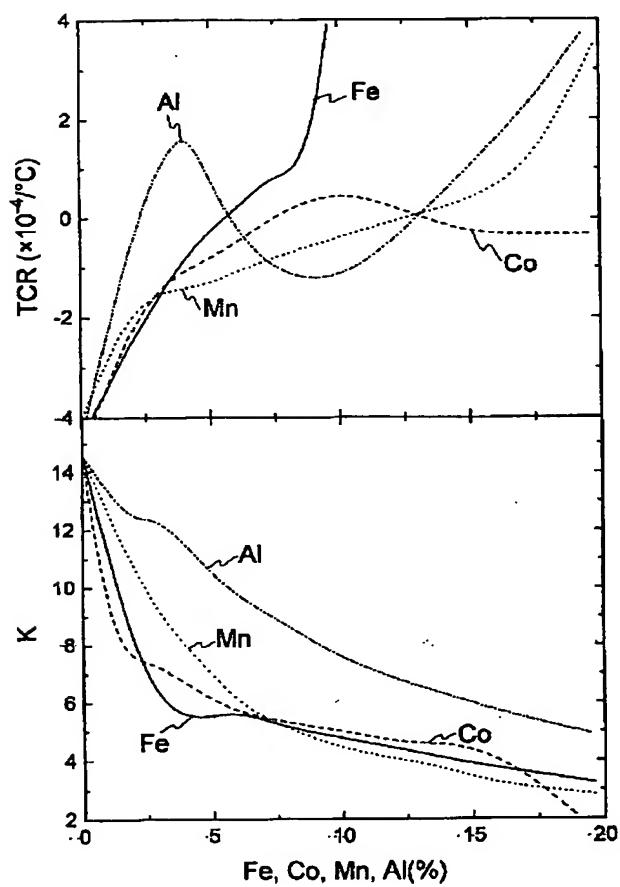
【図1】



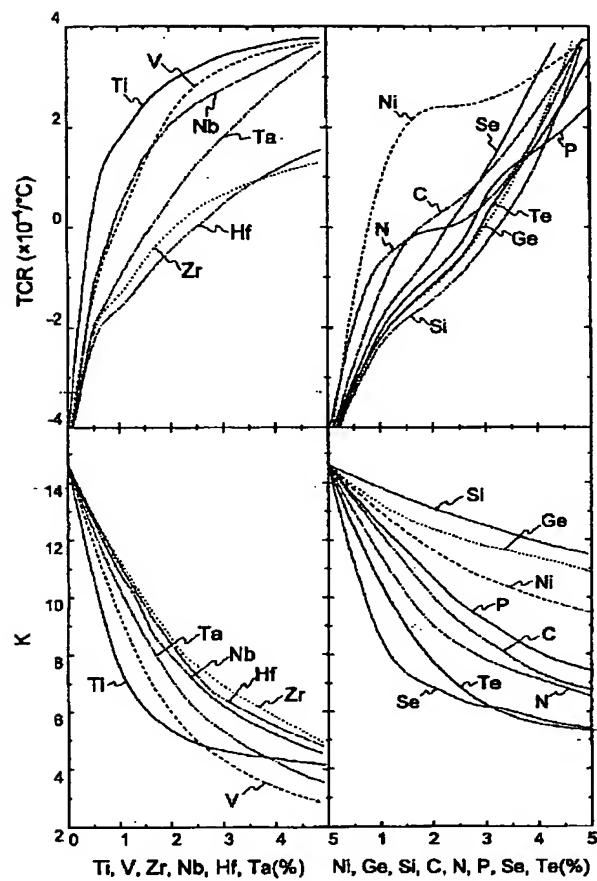
【図2】



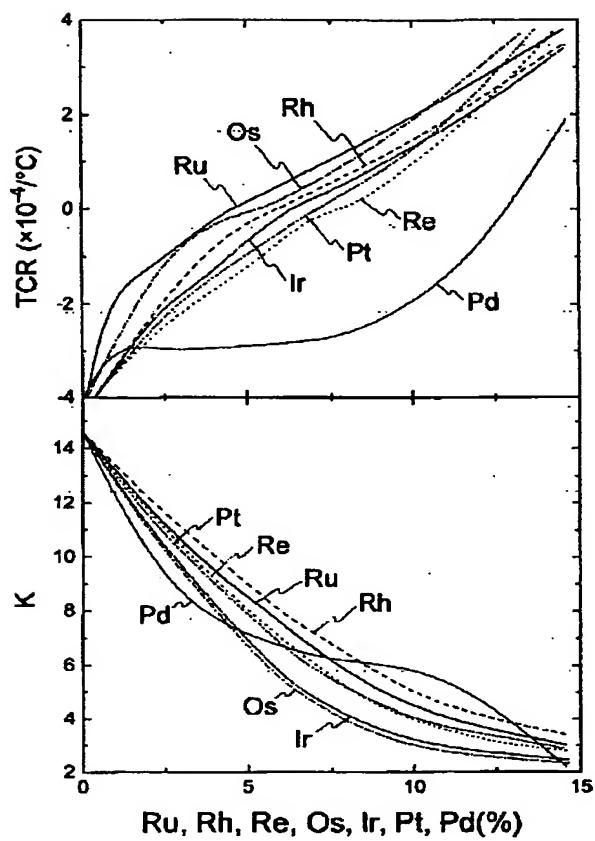
【図3】



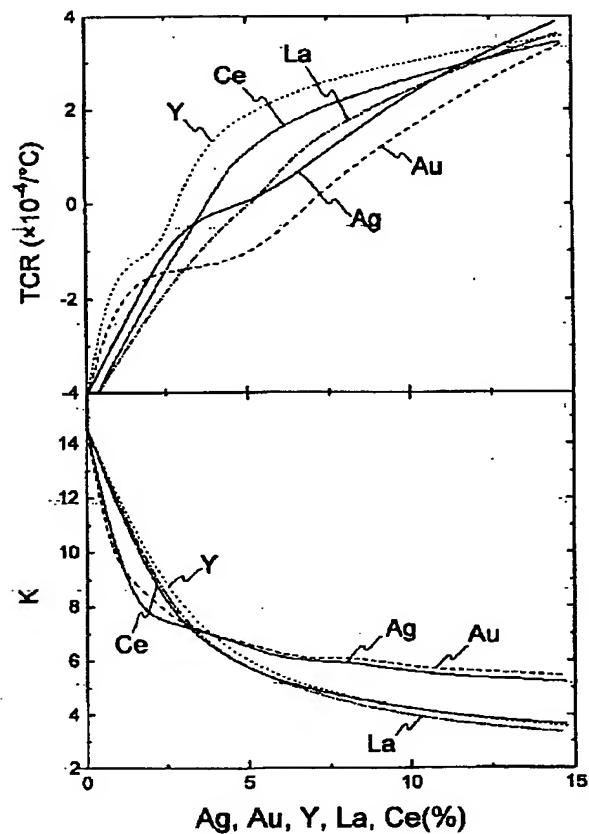
【図4】



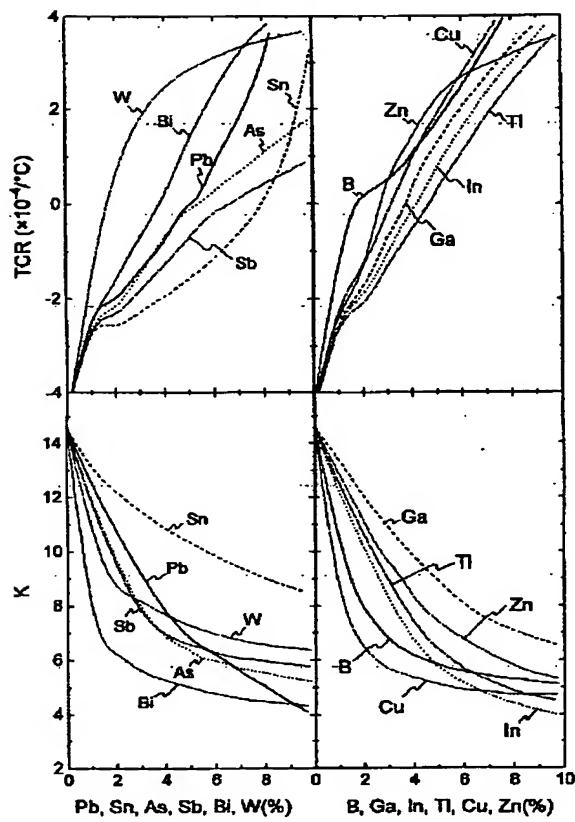
【図5】



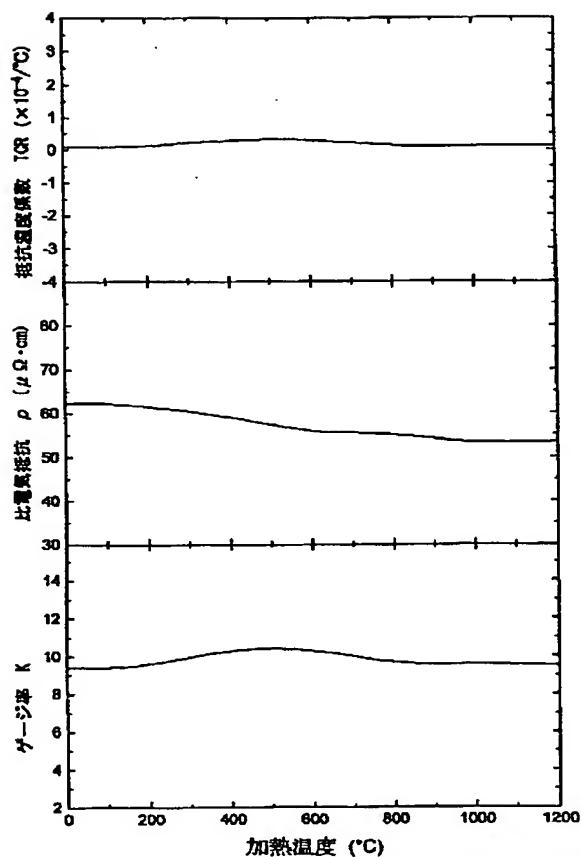
【図6】



【図7】



【図8】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.